

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 信达澳亚基金管理有限公司（杨宇）、宝盈基金管理有限公司（徐也）、天风证券股份有限公司（薛长安）、广东云杉常青证券投资基金管理有限公司（李福磊）、北京和源投资管理有限公司（王润）（排名不分先后）  |
| 时间            | 2024年3月6日（星期三）下午 14:30 至 16:30  |
| 地点            | 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间   |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、接待人员介绍公司基本情况</b></p> <p><b>（一）公司简介</b></p> <p>劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。</p> <p><b>（二）公司从事的主要业务</b></p> <p>公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及周边设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。此项业务系公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司2022年起规模化销售半导体专用设备，目前系公司集中资源发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备、硅片制造设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力；产品累计交付服务客户超过20家，获得客户的认可、验收及复购。</p> <p>3、公司主营产品还包含光电显示设备，应用领域覆盖 AMOLED 柔性</p> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>投资者关系活动<br/>主要内容介绍</p> | <p>屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程，产品突破海外技术封锁，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p><b>（三）公司的经营情况</b></p> <p>2023年前三季度，公司实现营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元。公司 2023 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》。</p> <p><b>二、问答交流</b></p> <p><b>1、公司半导体专用设备有哪些？应用领域有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>公司半导体专用设备目前以应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备为主，包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等，广泛应用于各类芯片元器件的封装过程及先进封装工艺，产品具体情况可以参见公司《2023 年半年度报告》。公司半导体专用设备目前主要面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，其中包含优质的上市公司、大型企业。</p> <p>公司未来将持续推动产品在 IGBT、IC 载板、Wafer Bumping、Clip Bonding、FCBGA 等生产制造领域应用，扩大客户群体、促进收入规模增长。</p> <p><b>2、公司半导体专用设备 2024 年业绩预期如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司半导体专用设备以应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备为主，其在技术和性能方面对标美国、德国等国的一些技术和产品成熟度较高的企业，同时具备价格、交期、售后服务等方面的优势，具有较强的进口替代实力。</p> <p>公司将继续把握相关设备国产化的产业机遇，面向下游封测厂商持续开展客户拓展、推进产品验证，在拓展产品应用领域的同时、有重点地培育细分市场客户群体，持续升级性能配置、满足不同客户和不同应用需求，夯实核心竞争力、促进收入稳健爬坡。</p> <p><b>3、电子装联业务下游应用领域有哪些？市场前景展望和 2024 年业绩预期如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域。</p> <p>近年来以智能手机为主的消费电子行业经历了一轮下行周期后，逐渐呈现企稳态势；汽车电子等领域受到新能源汽车市场需求旺盛等因素影响，</p> |
|---------------------------|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p>市场景气度相对好；泛消费电子行业呈现结构性行情，而大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术的应用，对于新型硬件需求产生刺激作用。行业需求回暖、固定资产投资复苏，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力。公司将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，不断推动电子整机装联业务持续高质量发展。</p> <p><b>4、公司光电显示设备后续前景展望如何？</b></p> <p><b>回复：</b>公司光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有 3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。</p> <p>电子产品终端市场需求回暖有望拉动上游显示模组需求增长，对公司光电显示设备的市场拓展和产品销售有积极影响。公司将继续保持与核心客户的合作粘性，争取深化核心客户合作、夯实差异化竞争优势、扩大对核心客户销售规模，增厚经营业绩。</p> <p><b>5、公司主要产品国产替代的情况是什么样的？</b></p> <p><b>回复：</b>电子装联业务方面，公司电子装联业务收入主要源于电子热工设备，热工设备在行业内市场地位和市场占有率领先。公司还将继续保持与核心客户的深度合作，把握海内外市场机会，力争提升市场占有率。</p> <p>半导体专用设备方面，公司生产的半导体专用设备目前主要为芯片封装的热处理设备，该产品对标美国等国产品和技术成熟度较高的企业，并能够满足客户的短周期交付需求，具备价格优势、快速响应的售后服务优势。半导体专用设备 2022 年起规模化销售，市占率有较大提升空间。</p> <p>光电显示设备方面，公司长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品系为突破海外技术封锁应运而生，具有国产替代实力。公司将视主要客户的固定资产投资和更新需求，积极把握机遇扩大销售规模。</p> <p><b>6、公司专用设备的价格是多少？</b></p> <p><b>回复：</b>公司专用设备分为电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备，根据不同设备用途、配置要求，以及定制化、智能化程度不同，价格会有一定的差异。</p> <p><b>7、公司专用设备的毛利率水平如何？</b></p> |
|----------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>投资者关系活动主要内容介绍</p> | <p><b>回复：</b>公司专用设备产品根据不同的产品类型、性能和配置要求，价格有所不同；同时销售规模、成本费用等也对毛利率有一定影响。公司专用设备产品综合毛利率、细分品类的毛利率情况，敬请参见公司披露的各期定期报告。</p> <p>公司拓展和丰富相对高毛利率的产品线，并主要通过研发创新和产品升级不断提升产品的竞争力、附加值，结合规模效应、降本增效等措施，稳定并力争提升综合毛利率水平。</p> <p><b>8、能否介绍 2023 年度业绩的具体情况？</b></p> <p><b>回复：</b>公司已于 2024 年 1 月 30 日披露 2023 年度业绩预告：2023 年度主要受到市场环境的影响，公司电子装联设备销售收入同比下降，致使营业总收入同比下滑、本报告期利润总额减少。公司加大研发和销售投入，相关费用增加对本报告期利润总额有所影响。</p> <p>公司当前主营业务经营情况稳健，未来将继续立足于电子装联业务基本盘，梳理和整合内外部资源、推动战略级业务半导体专用设备业务发展，力争把握产业趋势和结构性机会扩大收入规模、增厚业绩；同时继续落实资源利用、降本增效、精益生产和供应链管理系列措施，开源节流、提升盈利水平。</p> <p>公司正有序推进 2023 年度财务审计及《2023 年年度报告》编制工作，2023 年度具体经营情况敬请详见公司后续披露的《2023 年年度报告》。</p> <p><b>9、能否介绍一下公司近期公告退出投资的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司具体情况？</b></p> <p><b>回复：</b>该投资退出事项的具体情况，敬请详见公司 2024 年 2 月 8 日披露的《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告》及 2024 年 2 月 22 日披露的《关于部分投资退出的进展公告》。</p> <p><b>三、现场参观</b></p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间，接待人员详细介绍了公司产品的具体情况。</p> |
| <p>附件清单</p>          | <p>无</p>   |
| <p>日期</p>            | <p>2024 年 3 月 6 日</p>  |